

PRESSE-INFORMATION 7-2016

Erfolgreiche ITSC 2016 in Shanghai

Düsseldorf, 30. Mai 2016. In diesem Jahr fand die International Thermal Spray Conference & Exposition (ITSC) wieder im asiatischen Raum statt. Organisiert wurde die weltweit führende Fachveranstaltung rund um das Thermische Spritzen gemeinsam vom DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V., der TSS – Thermal Spray Society, ASM International und dem International Institute of Welding (IIW).

Unter dem Motto „Thermal Spray: Fostering a sustainable world for a better life!“ lockte die ITSC 2016 vom 10. bis zum 12. Mai 2016 über 1.300 Besucher in das Shanghai International Convention Center in Shanghai/P.R. China an.

Die sehr beeindruckende Teilnehmerzahl spiegelt die stetig steigende Bedeutung dieser in allen führenden Branchen weltweit eingesetzten Beschichtungstechnologien wider. Teilnehmer aus 28 Nationen informierten sich durch ein mit mehr als 300 Fachbeiträgen sehr umfangreiches Konferenzprogramm über den aktuellen Stand der Technik und zukünftige Entwicklungen. Erstmals lud außerdem ein anwendernahes Industrieforum über 100 Interessierte ein, sich praxisnah über Anwendungsbereiche und Ausrüstung rund um das Thermische Spritzen zu informieren. 64 Aussteller präsentierten auf der konferenzbegleitenden Expo ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen.

Die beliebte Poster Session bot den Besuchern auch in diesem Jahr an allen drei Tagen mit 108 Fachpostern ein breites Spektrum an relevanten Themen des Thermischen Spritzens.

1/...

.../2

Ein weiterer Höhepunkt der ITSC 2016 war die „Young Professional Session“. In Form eines Wettbewerbs präsentierten dabei 14 international aufstrebende Experten in jeweils fünf Minuten die wesentlichen Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeiten. Das Publikum legte im Anschluss daran den besten Beitrag fest. Der Gewinner wurde mit dem „Oerlikon Metco Young Professionals Award“ ausgezeichnet. Er ging in diesem Jahr an die Siegerin Amanda Wang von der School of Materials Science and Engineering, Australien.

Im nächsten Jahr wird die ITSC 2017 vom 7. bis zum 9. Juni 2017 in Düsseldorf stattfinden. Bis zum 30. September 2016 können interessierte Autoren ihre Vortragsangebote einreichen (www.dvs-ev.de/itsc2017). Der Einsendeschluss der Vorträge ist dann der 1. März 2017.

Ansprechpartner im DVS:

Dipl.-Ing. Jens Jerzembeck, T +49. (0)211. 1591-173, jens.jerzembeck@dvs-hg.de

Simone Mahlstedt, T +49. (0)211. 1591-302, simone.mahlstedt@dvs-hg.de